

FLUX CORED WIRE SOLDER

2006A スタンダードタイプ

初期濡れと、はんだキレ性を両立した製品です。
様々なはんだ付け用途で、ご利用可能です。

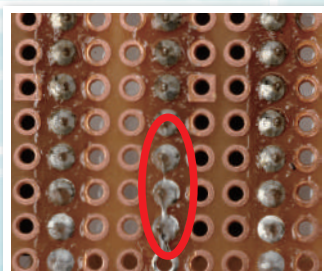
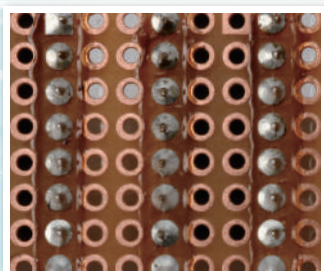
Fine Solder



Product Features 製品特性

■ はんだキレ性が抜群

コテ先温度が430℃と非常に過酷な条件で試験を実施しましたが、新規活性剤の採用により、はんだキレ性が良好で、ブリッジ・つのの発生を抑制出来ます。

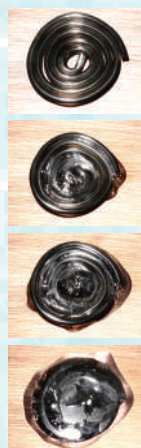


■ 初期濡れも大幅に改良

フラックスを改良した事により、初期濡れ(溶け出しのスピード)が速くなりました。低温域でも作業性が良好です。

φ 2006A

● 他社相当品 ●

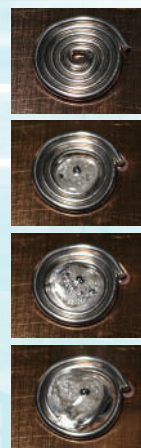


0.00秒

2.96秒

3.33秒

3.70秒



■ 試験条件

- ・ 引き速度：7mm/sec
- ・ はんだ線径：φ0.8mm
- ・ はんだ供給量：20mm/line
- ・ フラックス含有量：3%
- ・ コテ先温度：430℃

■ 試験条件 260℃±5℃

弊社品名	JIS記号	合金組成	固相線温度	液相線温度	線径 (mm)
FLF01	A30C5	Sn96.5%-Ag3.0%-Cu0.5%	約217℃	約219℃	φ0.3・φ0.4・φ0.5 φ0.6・φ0.8・φ1.0 φ1.2・φ1.6・φ2.0
FLF07	C7A3	Sn99.0%-Ag0.3%-Cu0.7%	約217℃	約226℃	
FLF03	C7	Sn99.3%-Cu0.7%	約227℃	約227℃	

項目	2006A	規格(参考)
		JIS Z 3283/A級
合金組成	FLF01/FLF03/FLF07	—
フラックス含有量	3%	2.7%以上3.3%未満
ハライド含有量	0.13%	0.1%を超え0.5%以下
水溶液比抵抗	700Ωm	500Ωm以上
絶縁抵抗試験(85℃ 85%RH 168hr)	2×10 ⁹ Ω以上	1×10 ⁸ Ω以上
マイグレーション試験(85℃ 85%RH 1,000hr)	異常なし	樹枝状生成物がない事
広がり率	75%	70%以上

